

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2022-083

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年11月13日签发的证监许可[2020]3024号文《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行244,000万元可转换公司债券，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币2,440,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计验资费用、资信评级费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币52,839,000.00元（含税），实际募集资金净额为人民币2,387,161,000.00元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第ZA10003号《验资报告》。

截至2022年3月31日止，本公司募集资金使用情况及结余情况如下：

募集资金账户情况	发行可转换公司债券募集资金额（元）
募集资金总额	2,440,000,000.00
减：发行费用	52,839,000.00
募集资金净额	2,387,161,000.00
加：累计利息收入及手续费支出净额	7,125,259.44
加：其他	1.00
减：置换以自筹资金预先投入募集项目	120,888,627.29
减：募集资金投入募集项目	474,289,742.20
募集资金账户余额	1,799,107,890.95

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至 2022 年 3 月 31 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	开户公司	银行账号	存放金额
招商银行股份有限公司上海张江支行	上海韦尔半导体股份有限公司	121908236710307	815,386.17
平安银行股份有限公司上海分行	上海韦尔半导体股份有限公司	15006188888809	394,246.34
中国民生银行股份有限公司上海分行	上海韦尔半导体股份有限公司	632634897	41,644.74
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	豪威半导体（上海）有限责任公司	216130100100280966	3,818,270.60
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	豪威半导体（上海）有限责任公司	216130100100307182	826,608,384.68
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	豪威半导体（上海）有限责任公司	216130100100307203	139,947,163.39
兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	豪威半导体（上海）有限责任公司	216130100100307312	56,397,580.88
平安银行股份有限公司上海分行	豪威科技（上海）有限公司	15119618888860	1.00
平安银行股份有限公司上海分行	OmniVision Technologies, Inc.	FTN15555788816865	771,085,213.15
合计	/	/	1,799,107,890.95

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、募集资金投资项目实施主体变更情况

2021 年 1 月 18 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》。公司决定将募投项目之一“CMOS 图像传感器研发升级”实施主体由豪威科技（上海）有限公司增加为豪威科技（上海）有限公司和 OmniVision Technologies, Inc. 共同实施。上述部分募投项目增加实施主体事项没有改变募集资金的用途和投向，

募投项目建设内容不发生变化。平安证券股份有限公司出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体的核查意见》，对公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体的事项无异议。

2、募集资金投资项目变更情况

2021年7月13日，公司召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十六审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。公司决定减少原募集资金投资项目之一“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”的投资金额，并将调整的募集资金用于新增的“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”、“高性能图像传感器芯片测试扩产项目”和“硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目”。可转换公司债券募投项目其他内容均保持不变。

本次募集资金变更前后情况如下：

单位：万元

变更前项目名称	变更前计划投入 募集资金总额	变更后项目名称	变更后计划投入 募集资金总额
晶圆测试及晶圆重构 生产线项目（二期）	130,000.00	晶圆测试及晶圆重构生 产线项目（二期）	18,441.54
CMOS 图像传感器研 发升级	80,000.00	CMOS 图像传感器研 发升级	80,000.00
补充流动资金	34,000.00	补充流动资金	34,000.00
		晶圆彩色滤光片和微镜 头封装项目	83,482.95
		高性能图像传感器芯片 测试扩展项目	20,899.15
		硅基液晶投影显示芯片 封测扩展项目	7,316.53
合计	244,000.00	合计	244,140.18

注：变更后募集资金合计金额与变更前募集资金合计金额差异为募集资金利息收入。

截至2021年6月30日止，“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”已累计使用本次募集资金14,890.17万元，募集资金使用率为11.45%。该项目募集资金专户产生利息收入140.18万元，募集资金专户余额为115,250.00万元，募集资金投资项目变更后，其中3,551.37万元将继续用于晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）项目投资，111,698.63万元拟变更用于晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目、高性能图像传感器芯片测试扩产项目和硅基液晶投影显示芯片封测扩产

项目。

本次募集资金项目变更有利于公司提高募集资金使用效率，抓住 CMOS 图像传感器行业的发展机遇，提升公司在相关领域的产品研发和生产能力，更好的满足下游多样化的市场需求。上述事项已经公司于 2021 年 8 月 2 日召开的 2021 年第一次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会议审议通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。平安证券股份有限公司出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司可转换公司债券募集资金投资项目变更的核查意见》，对公司本次变更可转换公司债券募投项目事项无异议。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2021 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币 120,888,627.29 元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2021]第 ZA13801 号《关于上海韦尔半导体股份有限公司以可转债募集资金预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》；平安证券股份有限公司出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

截至 2022 年 3 月 31 日止，公司发行可转换公司债券募集资金置换累计金额为 120,888,627.29 元。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2022 年 3 月 31 日止，公司使用公开发行可转换公司债券募集资金投资的项目尚未达到预定可使用状态，尚未产生经济效益。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“补充流动资金”项目募集资金全部用于补充公司流动资金，不适用单独核算实现效益情况。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2022年7月16日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			244,000.00			已累计使用募集资金总额：			59,517.83	
募集资金净额：			238,716.10			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：			111,558.46			2021 年：			53,253.22	
变更用途的募集资金总额比例：			46.73%			2022 年 1-3 月：			6,264.61	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使 用状态日期（或截止 日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额	实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额（注）	
1	晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）	晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）	130,000.00	18,441.54	18,125.68	130,000.00	18,441.54	18,125.68	-315.86	2022 年 5 月
2	CMOS 图像传感器研发升级	CMOS 图像传感器研发升级	80,000.00	80,000.00	3,086.76	80,000.00	80,000.00	3,086.76	-76,913.24	2024 年 3 月
3	补充流动资金	补充流动资金	28,716.10	28,716.10	28,716.10	28,716.10	28,716.10	28,716.10	0.00	不适用
4		晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目	0.00	83,482.95	965.83	0.00	83,482.95	965.83	-82,517.12	2023 年 7 月
5		高性能图像传感器芯片测试扩展项目	0.00	20,899.15	6,936.02	0.00	20,899.15	6,936.02	-13,963.13	2023 年 1 月
6		硅基液晶投影显示芯片封测扩展项目	0.00	7,316.53	1,687.44	0.00	7,316.53	1,687.44	-5,629.09	2023 年 8 月
合计			238,716.10	238,856.27	59,517.83	238,716.10	238,856.27	59,517.83	-179,338.44	/

注：由于公司募投项目尚在建设期，故实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差额。

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年度	2020 年度	2021 年度		
1	晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）	不适用	达产后年均净利润 12,425.22 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	CMOS 图像传感器研发升级	不适用	达产后年均净利润 26,625.25 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目	不适用	达产后年均净利润 10,354.88 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	高性能图像传感器芯片测试扩展项目	不适用	达产后年均净利润 2,787.64 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	硅基液晶投影显示芯片封测扩展项目	不适用	达产后年均净利润 2,695.71 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用